

创业邦获悉，进化半导体宣布完成近亿元人民币融资，资金将主要用于持续研发投入和团队扩充。本轮融资由中合汽车基金和同创伟业领投，国发创投、深圳高新投、浙商创投、泰融资本等知名投资机构跟投，老股东祥峰投资加注。

进化半导体是以国际首创无铍工艺制备超宽禁带材料氧化镓为特色的化合物半导体衬底企业，创立于2021年5月，专注于以创新技术制备氧化镓为代表的新一代半导体材料，致力成为国际一流的半导体关键材料生产服务商。

团队于业界首次提出“无铍工艺”理念和工艺路线，并已开发多种“无铍”制备工艺，将为我国新一代半导体产业的快速发展提供强有力支撑。

进化半导体团队拥有深厚的半导体材料生长、调控、加工等技术研发能力，以及半导体企业管理和市场拓展经验。公司立足于自主创新的关键核心技术，目前已取得阶段性进展，正在规划研发测试能力的升级建设。

氧化镓是具有更低成本、更高性能潜力的新一代半导体材料，其半绝缘衬底已于2021年12月的《瓦森纳协议》对华禁运，并于2022年08月由美国商务部正式宣布对华全面出口管制，是我国“十四五”规划中的“战略性先进电子材料”之一。

近年，国际氧化镓技术研发和产业化进程驶入快车道，日本业界已报道其车载逆变器测试效果喜人，将于2023年夏季开始批量向市场投放基于氧化镓器件的新能源车。

公司本轮融资的完成，将加快推动氧化镓材料的国产化进程，是产业链核心环节在新一代半导体产业生态布局中的重大进展，也是创新工艺构想加快向现实生产力转化的又一棒加速度接力。附